

TECHNICKÝ LIST

Měkká pájka:

Slitina: **S-Sn95,5Ag3,8Cu0,7**
Norma: ČSN EN ISO 9453 slitina č. 713

Základní charakteristika:

Eutektická bezolovnatá slitina používaná zejména v elektronice a elektrotechnice kdy je vyžadována velmi vysoká spolehlivost. Lze použít pro pájení vlnou, selektivní pájení a pájení máčením. Má nejnižší teplotu tání ze všech slitin SnAgCu. Vyznačuje se dobrou smáčivostí, vysokou mechanickou pevností a odolností vůči tepelným cyklům. Bezolovnatá alternativa SnPb pájek. Slitina splňuje požadavky směrnice RoHS.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Ag obsah: 3,6 – 4%
Cu obsah: 0,5 – 0,9%
Sn obsah: zbytek
Teplota tavení (liquidus/solidus): 217°C
Hustota: 7,5 g/cm³
Elektrická vodivost: 7,5 Ω mm²

Doporučená pracovní teplota: 260-320°C

Dodávané tvary a balení:

Tvářené tyče:

24x13mm – délka 350mm (tvářená)

Jiné tvary, rozměry či balení po dohodě.

Skladování a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodání při skladování v suchém (max. vlhkost 70 %) prostředí při teplotách od 5 do 25 °C.

Bezpečnost:

Používejte s dostatečným větráním a vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Veškeré specifické informace pro případ nouze naleznete v bezpečnostním listu.